

2025 年 9 月 1 日

各 位

SBS 東芝ロジスティクス株式会社

日本パッケージングコンテスト 23 年連続受賞！

－作業効率向上および環境負荷低減でダブル受賞－

SBS 東芝ロジスティクス株式会社（社長：金澤寧、本社：東京都新宿区）は、8 月 27 日、公益社団法人日本包装技術協会が主催する「2025 日本パッケージングコンテスト」において、包装技術賞の「ロジスティクス賞」と包装部門賞の「工業包装部門賞」をダブル受賞したことをお知らせします。また、今回の受賞で 23 年連続受賞となりました。



今回受賞した 2 つの事例は、当社の強みである「軽量品～重量品まで、作業性向上、環境負荷低減、コスト低減含めたトータルロジスティクス設計」を実現した包装技術になります。

■ロジスティクス賞 『部品を探さず取り出す！環境にやさしい箱』

従来は充填された小袋入り緩衝材の中に数十点ある部品が埋まって取り出しにくく、部品の取り忘れが無い複数人で確認を行う現状がありました。そこで搬入現場での部品探し時間の短縮、開梱・片付時間の短縮を目指して包装改善を行いました。箱内部を段ボール仕切り、ホルダー等で 4 層構造として各収納部品を固定できるよう工夫し、小袋入り緩衝材レス化を達成。開梱時に箱内の収納物が一目で確認出来るようになり、部品探し時間ゼロ化につなげ、開梱時間 60%削減、廃材片付時間 75%削減を実現しました。また、箱内の空間もコンパクトにすることで包装容積を 23%削減し、開梱後は小さく畳む事も可能で、搬入現場での作業時間短縮、包装材使用量削減、輸送負荷軽減、使用後の減容化までを実現しました。



■工業包装部門賞 『薄型基板用オール段ボールがっちり固定』

薄型基板は輸送等で製品に割れ・欠けが発生しやすく、従来はプラスチック緩衝材で、製品をがっちり固定してガタツキを抑えることで振動衝撃を緩和し品質を確保していました。今回、お客様の脱プラ要望で、プラ緩衝材ゼロでも信頼性を確保し、環境負荷低減に寄与するパッケージ開発を行いました。段ボールホルダの形状工夫で製品をがっちり固定・衝撃緩和し、プラ緩衝材使用ゼロ、包装サイズをコンパクトに設計。従来比で包装容積を 6 割低減し、包材コストおよび輸送コスト低減を実現しました。また、環境面では、包装プラスチック使用量 100%削減、CO₂排出量約 13%低減して環境負荷低減・持続可能性へとつなげました。加えて、自社で段ボール材の落下衝撃解析を活用し、お客様の製品品質確保と開発納期短縮へつなげました。



当社は、今後もトータルロジスティクス包装設計により、作業効率化や SDGs 視点での環境負荷低減・持続可能性の実現に努め、社会に貢献してまいります。

以 上

■ご参考

< S B S 東芝ロジスティクス株式会社 概要 >

本社住所：東京都新宿区西新宿 8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25 階

代 表 者：代表取締役社長 金澤 寧

設 立：1974 年 10 月 1 日

親 会 社：S B S ホールディングス株式会社（持株比率 66.6%）

資 本 金：21 億 28 百万円

売 上 高：963 億 98 百万円（単独）（2024 年 12 月期）

従業員数：796 名（2024 年 12 月期）

関連会社：S B S ロジスター(株) 他

事業内容：倉庫業、貨物利用運送事業、機械器具設置工事業、とび・土工工事業、通関業
航空運送代理店業、物流コンサルティング、不動産賃貸及び管理業

U R L：<https://www.sbs-toshibalogistics.co.jp/>

■本件に関するお問い合わせ先

S B S 東芝ロジスティクス株式会社 総務部

TEL：03-6772-8201（代表）／URL：<https://www.webcoms.jp/sbstlog/contact/>

※ 当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。